



Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ ORACL



/ Avantajlar

- Sağlam tasarım
- Ajustement rapide de 4 profondeurs de coupe
- 4 cutting depths
- Des stries au dos de l'outil qui facilitent la préhension du semiconducteur après incision

/ Faaliyet alanları

-  Kablo ve bağlantılar
-  Elektrik dağıtımı
-  Endüstri

/ Özellikler

- Spesifik araçlar : Kablo aletleri
- Kablo aletleri : Kablo hazırlama araçları
- Faaliyet alanları : Kablo ve bağlantılar, Elektrik dağıtımı, Endüstri
- For network cables : medium voltage
- Paketleme : Karton kutu
- Ağırlık (g) : 160
- Uzunluk (mm) : 135
- Genişlik (mm) : 55

- Yükseklik (mm) : 35
- Maksimum çap (mm) : 100
- Minimum çap (mm) : 10
- Kalan derecelendirme MIN (mm) : 10 (gaine) / 4 (écran)
- MAKS insizyon derinliği (mm) : 1.1
- Boylamasına kesme derinliği (mm) : 0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1
- Tools king : Specific tools

/ Yedek parçalar

	Referans	Tanımlama
	LSO	Blade for cutting the peelable semiconductor of MV cables

/ İlgili ürünler

	Referans	Tanımlama
	DSP	Peelable semiconductor lifter
	MVS	Stop for tools